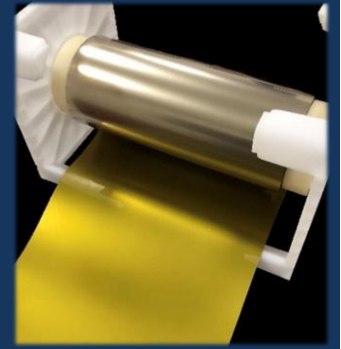


SUS/ポリイミド基板

高温面状発熱ヒーター用途に最適な
接着剤レスのSUS/ポリイミド基板



【特長】

- ・ 接着剤レスのため耐熱性に優れた SUS/ポリイミド積層材
- ・ 独自のポリイミド技術により高い接着力を発現
- ・ 低熱膨張性ポリイミドにより基材のフラット性に優れる

【基本構成】



層名	種類	厚み範囲 (標準)
ポリイミド	自社製ポリイミド	5-25 μ m (25 μ m)
SUS	SUS304	15-50 μ m (30 μ m)

【特性例】

層名	評価項目		単位	測定値
ポリイミド	電気特性	絶縁破壊電圧	kV	10.5
		体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	3.00E+15
		比誘電率 (5GHz)	-	3.4
		誘電正接 (5GHz)	-	0.013
	熱特性	線膨張係数	ppm/K	20
		5%重量減少温度	$^{\circ}\text{C}$	470
	機械特性	引張り強度	MPa	250
伸度		%	65	
引張り弾性率		GPa	7.5	
SUS/ポリイミド	機械特性	接着力	N/cm	12.3

※ 上記データはポリイミド厚み 25 μ m、ステンレス厚み 30 μ m の参考値です。

※ 基本構成以外の金属箔や厚み構成以外にも対応いたしますので、詳細はお問い合わせください

問合せ先 河村産業株式会社 <http://www.kawamura-s.co.jp>
 本社・四日市工場 〒512-8052 三重県四日市市西大鐘町 330 番地 TEL (059) 337-1122
 東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野 1-18-9 黒門平成ビル5階 TEL (03) 5846-8228
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-23-16 セントランドビル4階D室 TEL (06) 6476-7725